

Beyond 5G

多層プリント配線板

MEGTRON8プリント配線板

R-5795(N)/R-5680(N) (パナソニック株) 使用

- 信号高速化
- 伝送損失低減
- 優れたスルーホール信頼性
- 優れた耐熱性
- 鉛フリーはんだ対応

Tg (ガラス転移温度)

220°C/DMA

誘電率
(14GHz)

3.1

誘電正接
(14GHz)

0.0016

熱膨張係数Z
(α_1)
50ppm/°C

熱膨張係数Z
(α_2)
270ppm/°C

UL耐熱性
94V-0

耐熱性

288°C 120分

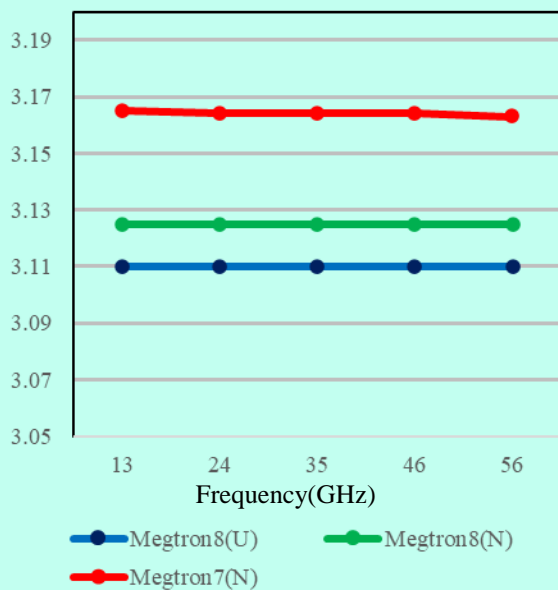
ピール強度

0.7kN/m

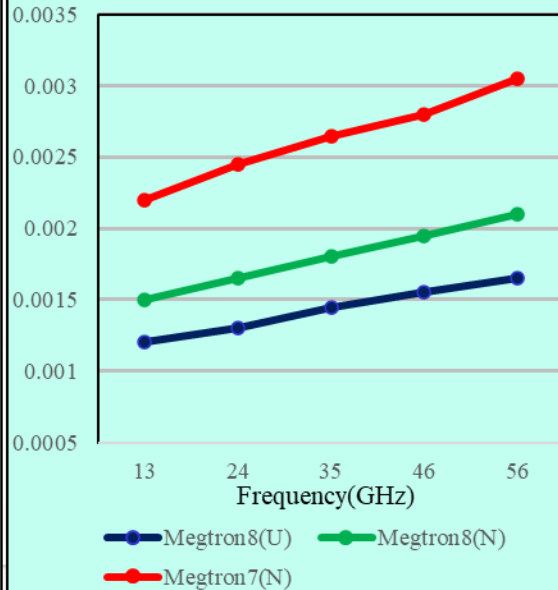
低粗度銅箔使用

H-VLP3

Dk



Df



cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認証

ISO14001
認証